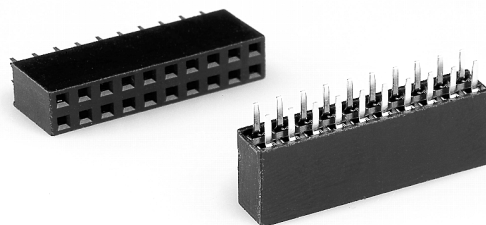


## Buchsenleisten RM 2,54 mm - Doppelfederkontakt - BH 7,1 / 8,5 mm

Female Header - Pitch 2,54 mm - Dual Beam Contact - Height 7,1 / 8,5 mm

### Technische Daten / Technical Data:

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94V0 <i>Thermoplastic, rated UL94V0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kontakt für Vierkantstift □ 0,635 mm, CuZn 30 <i>Contact for Square Pin □ 0,635 mm, CuZn 30</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3-2,5 µm) <i>acc. to options (see below), over Ni (1,3-2,5 µm)</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC512-12A
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	≤ 20 mOhm
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 10 <sup>9</sup> Ohm
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1000 V <sub>DC</sub>
Nennspannung <i>Current Voltage</i>	250 V <sub>AC</sub>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C...+105°C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T <i>Reflow-Soldering, further informations in chapter T</i>



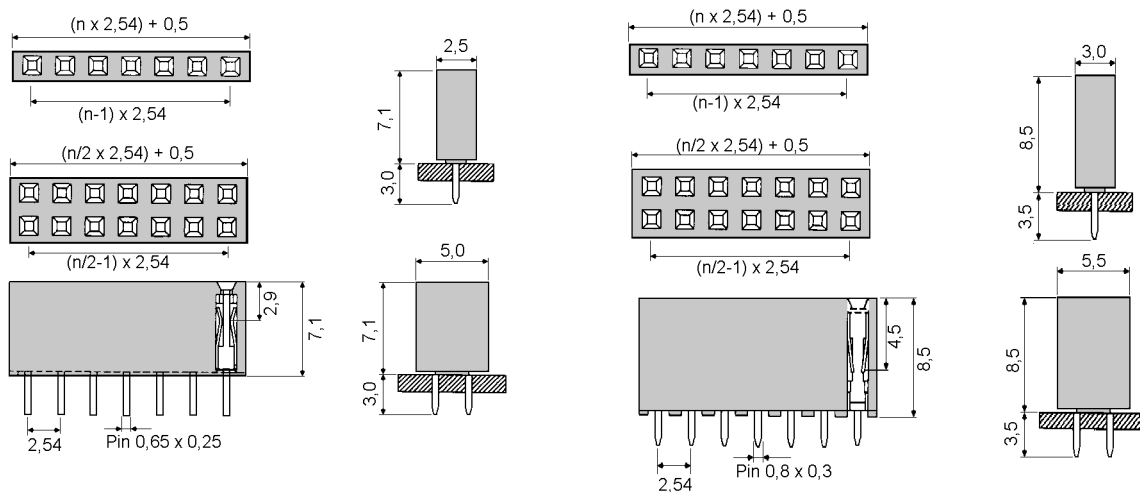
© W+P PRODUCTS

B

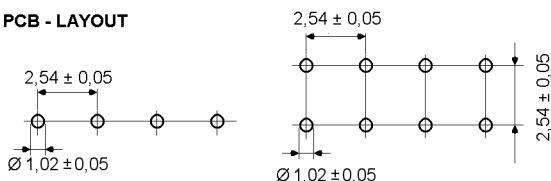
Doppelfederkontakt für Vierkantstift □ 0,635 mm  
*Dual beam contact accepts square pin □ 0,635 mm*

Height 7,1 mm

Height 8,5 mm



PCB - LAYOUT



n = Anzahl der Kontakte  
n = No. of Contacts

Series	Contacts*	Rows*	Type*	Plating*
624	72 02-36-pol. einreihig single row 04-72-pol. zweireihig double row	2 1 = einreihig single row 2 = zweireihig double row	20 10 = Bauhöhe 7,1 mm Height 7,1 mm 20 = Bauhöhe 8,5 mm Height 8,5 mm	60 00 = vergoldet gold plated 50 = verzinkt tin plated 60 = sel. Au/Sn duplex plating Au/Sn

(\* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* Order example - To be replaced by your specifications.)

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow-Soldering Informations

### Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte):

Profil Eigenschaft	Bleifreies Löten
Durchschnitts-Ramp-Up Rate ( $T_{s_{max}}$ to $T_p$ )	3 °C / Sek. Max.
Vorheizen - Temperatur Min ( $T_{s_{min}}$ ) - Temperatur Max ( $T_{s_{max}}$ ) - Zeit ( $t_{s_{min}}$ auf $t_{s_{max}}$ )	150°C 200°C 60-180 Sekunden
Verbleiben oberhalb: - Temperatur ( $T_L$ ) - Zeit ( $t_L$ )	217°C 60-150 Sekunden
Peak/Klassifizierung Temperatur ( $T_p$ )	260°C +/- 5°C
Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur (tp)	20-40 Sekunden
Ramp-Down Rate	6°C / Sekunde max.
Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur	8 Minuten max.

© W+P PRODUCTS

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):

Profile Feature	PB-Free assembly
Average Ramp-Up Rate ( $T_{s_{max}}$ to $T_p$ )	3 °C / second max.
Preheat - Temperature Min ( $T_{s_{min}}$ ) - Temperature Max ( $T_{s_{max}}$ ) - Time ( $t_{s_{min}}$ to $t_{s_{max}}$ )	150°C 200°C 60-180 seconds
Time maintained above: - Temperature ( $T_L$ ) - Time ( $t_L$ )	217°C 60-150 seconds
Peak/Classification Temperature ( $T_p$ )	260°C +/- 5°C
Time within 5°C of actual Peak Temperature (tp)	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C / second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:

Recommended Reflow-Soldering profile:



T